

要約

ダイパッドと、半導体チップと、封止樹脂とを備える半導体装置およびその製造方法が提供される。ダイパッドは、第1の面およびこれと反対の第2の面を有し、当該第2の面は露出部と当該露出部の周りの退避部とを有する。半導体チップは、ダイパッドの第1の面に搭載されている。封止樹脂は、ダイパッドの露出部を露出させつつ退避部に接してダイパッドおよび半導体チップを覆う。

App. No. 09/715,562
Patent Pending
U.S. A. G. P. - U.S. Patent and Trademark Office "Employee Mail" Post
Oct. 17, 2001
Serial No. 09/715,562, filed Oct. 17, 2000, in the
name of the above and is addressed to the
U.S. Patent and Trademark Office, Washington,
D.C. 20593.

CHRISS STORDAHL
ChriSS
P. 2001-10-17
S. 09/715,562